



2017年10月11日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表者名 代表執行役社長 綱川 智
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 執行役常務 広報・IR部長
長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

(開示事項の経過) 東芝メモリ株式会社四日市工場第6製造棟に
導入する生産設備の投資について

当社は、本日開催の取締役会において、3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」の生産拡大のために当社子会社である東芝メモリ株式会社（以下、東芝メモリ）の四日市工場（三重県四日市市）にて建設中の第6製造棟に導入する生産設備の投資について、下記のとおり承認いたしましたので、お知らせいたします。

記

当社は、2017年8月3日付「(開示事項の経過) 東芝メモリ株式会社四日市工場第6製造棟に導入する生産設備等の投資について」にて、建設中の第6製造棟に関し、第1期分の生産設備及び第2期分の建屋建設投資として、総額約1,950億円の投資を東芝メモリが実施することを公表しておりました。

このたび、エンタープライズ用サーバやデータセンター向けを中心に3次元フラッシュメモリの需要拡大が2018年以降も見込まれることから、これに対応すべく、第1期分としてさらに約1,100億円の投資を東芝メモリが2017年度中に実施することについて(以下、本投資)、当社取締役会にて承認いたしました。

これにより、第6製造棟の建設進捗に合わせ、第1期分の建屋内に96層積層プロセスを用いた3次元フラッシュメモリ固有の製造工程を担う最先端の成膜装置やエッチング装置などを導入します。本投資に関する費用計上や支払いによる資金影響等は2018年度以降となるため、2017年8月10日に公表の当社2017年度連結業績見通しに変更はありません。2017年度のストレージ&デバイスソリューション向け設備投資額(発注ベース)は2017年8月10日公表の見通し値3,300億円から、今回、これまで具体的な投資計画に落とし込んでいなかった400億円と2018年度に予定していた設備投資のうち700億円の合計1,100億円をメモリ事業領域にて発注することにより4,000億円となります。また、当社は2016年3月17日付「半導体製造棟の建設について」にて、メモリ事業として、四日市工場の新たな製造棟の建設と

生産設備へ2016年度以降3年間を目途に約3,600億円の投資を見込んでいる旨、お知らせしておりましたが、3カ年投資計画については、今後状況に応じて更新いたします。

なお、本投資に対する米国サンディスク社による投資参加の有無につきましては、現在同社へ提案し協議中です。

以上